(19)日本国特許庁(JP)

(12) 公開特許公報(A)

(11)特許出願公開番号

特開平11-323052

(43)公開日 平成11年(1999)11月26日

(51) Int.Cl. ⁶	識別記号	F I
C08L 27/16		C 0 8 L 27/16
C 0 8 J 5/18	CEW	C 0 8 J 5/18 C E W
C 0 8 K 5/42		C 0 8 K 5/42
G 0 2 B 6/00	3 8 6	G 0 2 B 6/00 3 8 6
G 0 3 G 15/02	1 0 1	G 0 3 G 15/02 1 0 1
		審査請求 未請求 請求項の数20 OL (全 13 頁)
(21)出願番号	特顧平11-63378	(71) 出願人 000001100
		呉羽化学工業株式会社
(22)出顧日	平成11年(1999) 3 月10日	東京都中央区日本橋堀留町1丁月9番11号
		(72)発明者 北村 秀樹
(31)優先権主張番号	特願平 10-82748	茨城県新治郡玉里村上玉里18-13 呉羽化
(32)優先日	平10(1998) 3月12日	学工業株式会社樹脂加工技術センター内
(33)優先権主張国		(72)発明者 松永 悟
		茨城県新治郡玉里村上玉里18-13 呉羽化
		学工業株式会社樹脂加工技術センター内
		(72) 発明者 寺本 嘉吉
		茨城県新治郡玉里村上玉里18-13 呉羽化
		学工業株式会社樹脂加工技術センター内
		(74)代理人 弁理士 西川 繁明

(54) 【発明の名称】 ポリフッ化ビニリデン系樹脂組成物

(57)【要約】

【課題】 $10^\circ \sim 10^\circ \Omega \, c \, m$ の範囲で所望の体積抵抗率を安定して均一に精度よく発揮することができ、環境湿度変化による体積抵抗率と表面抵抗率の変化が小さいポリフッ化ビニリデン系樹脂組成物を提供すること。また、高い光線透過率と低い曇価を有する透明性に優れたポリフッ化ビニリデン系樹脂組成物を提供すること。さらに、このような半導電性及び、または透明性に優れた樹脂組成物を用いて、各種成形物を提供すること。

【解决手段】 ポリファ化ビニリデン系樹脂100重量部に対して、アルキル四級アンモニウム硫酸塩及びアルキル四級アンモニウム亜硫酸塩からなる群より選ばれる少な とも一種の化合物を0.03~10重量部の割合で含有するボリフッ化ビニリデン系樹脂組成物。

【特許請求の範囲】

【請求項1】 ポリコ /化ビニリデン系樹脂(A)10 ○重量部に対して、式(1)

【fi: 1 】

$$\begin{bmatrix} R^{1} \\ I \\ R^{2} - N - R^{4} \\ I \\ R^{3} \end{bmatrix} R^{5}SO_{4}$$
 (1)

(式中、 $R^1 \sim R^4$ は、互いに同一または相異なるアル キル基であり、Rid、アルキル基、アルオロアルキル 基、または水素原子である)で表されるアルキル四級ア シモニウム硫酸塩(B1)、及び式(2)

[4:2]

$$\begin{bmatrix} R^8 \\ R^7 - N - R^9 \\ R^8 \end{bmatrix} R^{10}SO_3$$
 (2)

(武中 Rf~R)は、互いに同一または相異なるアル キル基であり、RPは、アルキル基、フルオロアルキル 基、または水素原子である)で表されるアルキル四級ア ンモニウム亜硫酸塩 (B2) からなる群より選ばれる少 な「ヒも一種の化合物(B)をロ」ロ3~10重量部の 割合で含有するボリノン化ビニリテン系樹脂組成物。

【請求項2】 ポリコッ化ヒニリデン系樹脂(A)が、*

$$R_{\alpha} - D_{\alpha} / (D_{\alpha} + D_{\beta})$$

で定義される吸元度比R a がり~0.8 の範囲内である 請れ項1記載のポリコッ化ビニリテン芸樹脂組成物。

【請ま項10】 示差走査熱量計を使用して、昇温開始 30 温度30℃、昇温速度10℃。分の条件で測定した際 に、185~200°Cの温度範囲内に小なくとも1つの 吸熱ビークを示す請求項1記載の樹脂組成物。

【請求項11】「電子写真装置または静電記録装置の帯 電部村に用いられる樹脂材料である請は項1記載の樹脂 組成物。

【請求項12】 請求項1乃至11のいずれか1項に記 載のポリニッ化ヒニリデン系樹脂組成物からなる成形。 物。

【請求項13】 ニート、ファイバー、または射出成形。40 物である請求項12記載の成形物。

【請水項14】 荷電制御部村である請求項12記載の 戊升:物。

【請述項15】 荷電制御部村か、電子写真装置または 静電記録装置における半導電性部材である請求項14記 載の成形物。

【請求項16】 半導電性部村が、ヤング率1.0GP a以上のバルト状またはシート状部材である請求項15 記載で成形物。

* ファ化じニリデンのホモポリマーである請求項1記載の 樹脂組成物

【請求項3】 ポリソラ化ビニリデン系樹脂(A)が、 1、化ビニリデンと他の共重合可能なモノマーとの共軍 合体である請求項1記載の樹脂組成物。

【請求項4】「ソッ化ビニリデン共軍合体が、アッ化ビ - ペキサブルオロプロピレン共重合体、アラ化 ゼニリテン テトラフルナロエチレン共重合体、または フラ化しニリデントテトラフルオロエチレントペキサブ ルオロプロピレル 共軍合体である請求項3記載の樹脂組 成物。

【請求項5】 アルキル四級アンモニウム硫酸塩(B 1) か、アルキル四級アンモニウム硫酸水萃塩である請 **水項1記載の樹脂組成物。**

【請求項6】 アルキル四級アンモニウム硫酸水素塩 が、ゲトラブチルアンモニウムハイドロゲンサルフェー 上である請求項5記載の樹脂組成物。

【請求項7】 | 曇価が40%以下である請求項1記載の 樹脂組成物。

【請求項8】 - 体積抵抗率が10゚~10°Ωcmの範 囲内である請求項1記載の樹脂組成物。

【請求項9】 - 5 3 1 cm における赤外線吸収スペク トルの販売度をDaとし、511cm における赤外線 吸収スペープトルの吸光度をDaとしたとき、式(1)

数1

(I)

※1 系樹脂組成物がら形成された表面層を有するロール状 部村である請求項14記載の成形物。

【請求項18】 - 荷電制御部村が、電子部品包装材、壁 派、OA機器外装材、帯電防止の間仕切り、または粉体 室装材の搬送チューフである請求項11記載の成形物。

【請求項19】 元学部村である請求項12記載の成形

【請求項20】 売学部材が、カファイバー、光ファイ ノーの鞘成分、光学しょス、窓ガラス、窓ガラス保護 材、ディスプレイ保護材、CRT保護材、大陽電池の透 売材または照明のカバーである請求項19記載の成形: 4%

【発明の詳細な説明】

[0001]

【発明の属する技術分野】本発明は、ポリコー化ビニリ テン系樹脂組成物に関し、さらに詳しては、半導電性及 **ひっぱたは透明性が要求される分野に好適に使用するこ** とかてきるボリファ化ビニリテン系樹脂組成物に関す る。本発明の樹脂組成物は、半導電性を活かして、例え は、電子写真方式の画像形成装置における帯電ロール。 ●、ゲロール、画像ロール、帯電・ルト、陥電べルトなど の荷電制御部村(半導電性部村)の少な とも表面層を 【請求項17】 半導電性部村が、ポリファ化ビニリテ※50 用成する樹脂材料として好適である。また、本発明の樹

脂組成物は、制電性、帯電防止性、塵埃吸着防止性など を活かした用金、例えば、電子部品包装材(例えば、コ ィルム、袋、存器)、壁紙、OA機器外装材、帯電防止 の間仕切りなどの荷電制御部材として好適である。

【ロロリコ】な発明において、主導電性の樹脂組成物と は、体積抵抗率が絶縁体と金属導体との中間に位置する 樹脂材料を意味し、より具体的に、10°~10¹³Ω c m程度の体積抵抗率を有する樹脂組成物を意味する。 な 発明の樹脂組成物は、透明性(高い光線透過率と低い量 価)を括かした用金として、光ファイベーやレンズ。大「10」 碼電池の透光材、照明のカバーなどの光学部村用の樹脂 村性として好適に使用される。本発明の樹脂組成物は、 半導電性と透明性の両方の特性を括がして、塵埃吸着防 正性の窓ガラスペディスプレイの保護材などの光学部材 にも好適に使用される。

[0003]

【逆来の技術】電気・電子機器の分野において、半導電 性材料として、体積抵抗率が精密に制御された樹脂材料 が求められている。例えば、電子写真方式の復写機や17 テクンミリ、レーザービームプリンターなどの画**像**形成 20 装置(電子写真複写機、静電記録装置など)において は、帯電、露光、現像、転写、定着、除電の各工程を経 で画像が形成されている。これら各工程で使用される各 種部村を形成するには、体積抵抗率を精密に制御された。 樹脂材料が必要である。

【0004】このような画像形成装置に装着されている 帯電ロールまたはベルト、転写ロールまたはベルト、現 像ロール、トナー層厚規制プレートなどには、少なこと もその表面層が平導電性であること、具体的には、10 「~10°Qcmの範囲内の所望の体積抵抗率を有する」 ことが要求されている。例えば、帯電ロールまたはベル 上を用いた帯電方式では、電圧を印加した帯電ロールギ たは、ルトを感光体トラムに接触させて、感光体ドラム 表面に直接電荷を与え、一様から均っに帯電させてい。 5。現像ロールを用いた現像方式では、現像ロールビト ナー供給ロールとの間の摩擦力により、トナーを現像ロ ·-ルの表面に帯電状態で吸着させ、これをトナー層厚規 制プレードで助しにならした後、帳光体ドラム表面の静 電潜像に対して電気吸引力により飛翔させて現像してい る。転写ロールまたは、ルトを用いる転写方式では、転 40 写ロールまたはベルリにトナーと逆極性の電圧を印加し て電界を発生させ、診電界によって生ぜる電子吸引力に よって感光体下のトナーを動写相上に転写させている。

【0005】したかって、画像無成装置における費電は ールやニルトなどの荷電制御部村には、適度の範囲の低 い体積抵抗乳を有することが要求される。また、その体 積抵抗率は、均一であることが必要であり、場所的に体 積抵抗率が異なると、高品質の画像を得ることができな い。例えば、帯電ロールまたは、ルトの体積抵抗率が均 一てなければ、感光体表面を一様か一均一に帯電させる。50

ことができず、画像の品質が低下する。さらに、これら の部村には、湿度の変化によって、体積抵抗率や表面抵 抗率があまり変化しないことが望まれる。通常の使用環 境上での位度変化によって、荷電制御部村の体積抵抗率 や表面抵抗率が大幅に要化すると、安定して高品質の画

像を得ることがてきない。

4

【0006】また、樹脂材料から形成されているOA機 器の外装材や部品などは、磨磨やトナーなどを吸引する と、外観を損ねたり、故障の原因となる。電子工業にお ける半導体デバイスやLCDなどの製造工程で使用され る樹脂製の装置や部品、10ミエS1などの電子部品を 包装するためのフィルムや袋、容器は、静電気の発生に より塵埃を吸着すると、電子部品の品質を損なら、その ため、これらの用金、特にその表層材に使用される樹脂 材料には、10゚~10°Ωcm程度の体積抵抗率を付 与して、荷電制御性を持たせることが求められている。

【0007】従来、ポリソッ化ビニリデン系樹脂やその 成形品の電気抵抗 (体積抵抗率) を下げる方法として は、(1) 樹脂成形品の表面に有機希帯電防止剤を棄布 する方法、(2) 樹脂に有機系帯電防止剤を練り込む方 法、(3) 樹脂にカーボンプラッツや金属粉などの尊電 性フィヤーを練り込む方法、及び(1)樹脂に不才に電 解質を練り込む方法が知られている。

【0008】しかしなから、(1)わ方法は、ポリノノ 化ビニリデン系樹脂が非粘着性に優れているため、成形 品表面を拭いたり、洗浄したりすることによって、帯電 防止剤が容易に脱落してしまう。 (2) の方法では、有 機系帯電防止剤として、界面活性剤や親水性樹脂を用い ている。 界面活性剤を用いる方法では、成形品表面がら | 界面活性剤をプリートアウトさせることにより帯電防止 性を付与する機構を採用しているため、温度や湿度など の環境の変化によって、体積抵抗率や帯電防止性が大き 。要化する。また、プリツッ化ビニリテム系樹脂の長所 である面特集性が損なわれる。親水性樹脂を用いる方法、 では、所望の帯電防止効果を得るには、親水性樹脂を多 量に配合する必要があるため、ポリファ化ビニリテン系 樹脂本来の耐汚染性、耐候性、耐壮プン性、耐溶剤性な どの物性が低下し、しかも、体積抵抗すや帯電防止性の 湿度依存性が大きいという問題がある。耐汚染性や価格 **剤性は、電子写真方式の画像形成装置に配置される部材** において、とサーが付着した際に、それをクリーニレク する場合に次められる性質でもある。コロナ放電装置な とを装着した画像形成装置は、十二年を発生するので、 而けた! 性も部材に求められる性質である。耐候性は、 屋外で使用される看板や窓ガラスの表面保護材として使 用される場合に求められる性質である。

【0 0 0 9】前記(3)の方法は、多二の分野で採用さ れている。例えば、帯電ロールは、樹脂に導電性 1 ィラ --を練りけんた半導電性樹脂組成物を芯金上に被覆して - 刑成されている。1 かしなから、樹脂中に導電性フィラ

一を分散させた半導電性樹脂組成物は、一般に、体積抵 抗れの分布が極めて不均一で、そのばらつきは、多一の 場合、数桁に上るものであり、乗用性能上問題があっ た。特にポリファ化ビニリデン系樹脂は、表面エネルギ 一か小さいため、運電性フェラーを分散させた場合、高 電圧の印加などによって導電性フィラーが樹脂中を移動 し、その結果、体積抵抗率が変動してしまうという問題 かあった。しかも、導電性 フィラーを分散させたポリア >化ビニリデン系樹脂組成物は、一般に耐電圧が充分で はなり、高電圧を繰り返し形加せる用途には必ずしも適し10。 さない。また、導電性フィラーを用いて必要とされる半 海電性の水準を達成するには、その充填量を多しする必 要があり、そのため、ポリコン化ビニリテン系樹脂組成 物の成形加工性や機械的強度が低上したり、あるいは硬 度が高くなりすぎたりするという問題が生しる。 さら に、尊電性フィラーを分散させたポリフッ化ビエリデン 手樹脂組成物は、尊電性カーポンプラックなどの尊電性 ツィラーによって着色していることが多いため、例え ば、OA機器の外装材や壁紙などの用金に適用するには た適当である。

【0 0 1 0】前記(4)のイオン電解質を練り込む方法 は、ポリファ化ビニリデン (PVDF) かイオンの良尊 体であることが古りから知られていること(例でば、特 開昭51 32330号公報、特開昭51 11065 8号公報、特開昭51 111337号公報、特開昭5 1 127872号公報)からみて、ポリファ化ビニリ テン系樹脂に半導電性を付与するのに有助な方法である ことが期待される。ところが、電解質として代表的な塩 孔りチウムや塩化カリウムなどの無機金属塩をポリフィ 化ビニリデン系樹脂に練りせんた樹脂組成物は、これら 30 の無機金属塩が当該樹脂に僅かしか溶解しないため、体 積抵抗率を1×10°Ωem以下にするのは困難であっ た。また、過剰に添加した無機金属塩の凝集物がフィッ シュアイの原因になるなどの問題があった。この凝集物 をボリノ、化ビニリテン系樹脂に容解させるために、混 練温度を上げたり、混練時間を長っしたりすると、樹脂 及び、「または電解質が分解して、実質的な機械物性や外 観を損なう。さらに、Li塩のような刺解性のある金属 塩の場合。樹脂に多量に充填すると、樹脂組成物が吸湿 性を持っようになるため、湿度の変化によって体積抵抗。 率が大きく変化したり、プリードアウトした金属塩の樹 解物により成形品の表面がったっこという問題が生し .

【0011】電解質の樹脂に対すら結解性を向上させる ための方法として、特開昭60~177061号公報及 ひ特開昭61~70061号公報には、プロヒレンカー ボネイトなどの極性溶剤を樹脂に含ませる方法が提案さ まれている。しかし、この方法では、樹脂のY122率か著 も一低工したり、ブロードアウトした電解質と結剤によ って樹脂才面がべたったなどの問題があった。

【0012】従来より、四級アンモニウム塩を樹脂の帯 電防止剤として使用する方法が提案されている。例え ば、特開昭 4.6 6 4.9.8.9号公報には、四級アンモニ ウム塩と樹脂とを有機溶剤に溶解した帯電防止コーティ 2/7村が開示されている。しかし、このコーディング村 は、冼舟によって脱落し易く、長期間の帯電四上的果を 持続せるのは困難である。特開昭 4.7~3.8.3.5 号公報 には、四級アンモニウム塩をポリナレフィンに練り込ん だ掛電防止性10-1が開示されている。 しかしながら、 この帯電時上性、一下は、四級アンモニウム塩が樹脂が らプリートアウトすることによって帯電防止効果を発揮 する機構であるため、温度や湿度などの環境変化によっ で、その導電性と帯電防止効果が大き「変化してしま。

6

う。しかは、ポリオレフィンのような極性の小さい樹脂 中では、電解質がイオン化し難いために、表面抵抗率を 三げることはできても、体積抵抗率は上げることができ なかった。さらに、ほどんどの四級アンモニウム塩、特 にいロゲン化四級アンモニウム塩は、熱安定性におった め、ポリファ化ビニリデン系樹脂(この樹脂の加工温度 は、220~270℃程度である)と容融混合すると。 成形品に発泡や着色などの不具合が生ぜる。

【0013】また、多くの金属塩や四級アンモニウム塩 は、特に高程度環境下でプリードアウトし場で、例で ば、半導体デバイスの製造工程において、制電性包装材 表面の金属不純物が製品の工良化の原因になったり、電 子写真方式の画像形成装置に装着される転送ロールや。 ルトにおいては、樹脂中の電解質の減少によって表面層 の体積抵抗値が変化し、画質が低工してしまうなと問題

【0014】光学料料に関して、近年、オプトエレフト ロニクス分野では、軽くて加工性に優れた樹脂透明材料 か強くおめられている。しかし、光学用途に使える透明 樹脂材料は、ポリメチルメダクリレート、ポリカーエネ ート、ポリスチレン、脂肪族環状構造を有するような… 部のオレフィン樹脂などに限られていた。ところか、こ のような従来の樹脂を、例えば、コンパフトディスクや 元磁気学 モスクのビックアップレンスに用いると、ポリ メチルメダクリ1ペート、ポリスチレン、ポリカーホネー 上のような吸湿し易い樹脂は、吸湿による守独変化や帰 折率の変化がよう。その表面から進行ともため、レンツ全 体の特性が判断したなる。そして、それによって、いっ サー光の波面が割れ、書き足み読み取りの両方に悪影響 を及ぼすという問題があった。また、自動車に搭載する ロミッドケトディスクラグレーヤのピックア バプレンスに は、100~130℃、あるいはそカガーの耐熱性が要 求されるが、ポリマチルメグラリレーしては、その要求 を満足させることは難しかった。

【0015】さらに、プロシェクションテレビやカメラ などの一般の光学新では、1枚のレングでは、どうして も元の波長によって焦点距離差が出る色収差が生じてし

まうため、屈折率とアッド数の異なる複数の材料を組み合わせて、色収差を解消する。色消し、という設計が必要となる。ガラフレンフでは、屈折率とアッド数の異なるガラフは200種類以上に及ぶため、色消し設計は比較的容易であるか。プラスチッドレンスだけを使用した場合には、前記のように使用できる透明樹脂材料は数種類しかないとに、苔樹脂材料の屈折率が1、5~1、6付近に集中しているため、色消し設計が非常に難して、この分野では、新規な透明樹脂材料が常によめられていた。

【0016】元プァイニーには、石英ガラスや多成分ガラスをじ(コア)成分や鞘(ユラット)成分とするカラス系元プァイニーのほかに、岩成分及び鞘成分をとれにプラスチッツが正井成したプラスチッツ元ファイニーが知られている。プラフチッツ系元ファイニーは、ガラス系元プァイニーと比較して、製造及び取り扱いが容易で、変価であるが、その一方で、耐久性と耐熱性にあり、伝き損失が大きいという欠点を持っていた。

【0017】 ポリファ化ビニリテン(PVDF)は、耐熱性及び耐候性に優和、吸湿が少なく、屈折率が1.12程度で他の透明樹脂と比較して小さいことがら、アラフチック系元ファイバーの鞘成分として期待されている。しかし、PVDFは、加工成元の際、結晶化によって自濁し場いため、例えば、特開昭63 22872号公報、特開平1 97901号公報、特開平5 60931号公報、特開平8 106019号公報などでは、アフリル樹脂とフレントして透明化する方法が提案されている。ところが、PVDFとアプリル樹脂をブレントすることにより、PVDFの特徴である耐熱性、耐候性、排吸湿性が低圧し、屈折率もアプリル樹脂に近付いてしまらなどの欠点があった。さらに、樹脂とうしのフレント系は、光学的にで均一になり易し、光散制が大きいという問題がある。

【0018】 ポリソー化ビニリテン新樹脂は、優れた耐候性を活かして、事務用品、看板、建築材料などの表面保護材として使用されているが、窓ガラスやCRTの保護ファルムとして使用するには、透明性に不満かあった。

【0019】 ポリアっ代にエリテン系樹脂の透明性を向上させる方法としては、従来より、KCIやNaCIな 40との無機塩を結晶柱剤として使用する方法や、実質的に未延伸のシート状または主動成形物を一治延伸または高温高圧条件下で延伸する方法が提案されている。しかし、無機塩を採却する方法は、最集物がフェッシンでの原因になるなどの問題があった。実質的に未延伸のジート状または主要成形物を、治延伸または高温高圧条件下で延伸する方法は、肢大な加工設備が必要であり、生産性に問題があった。また、どちらの方法を、透明性の改善効果は不充分であった。

[0020]

【発明が解決しようとする課題】本発明の目的は、10°~10°Ωcmの範囲で所望の体積抵抗率を安定して 均一に精度よ「発揮することができー環境最度を化による体積抵抗率と表面抵抗率の変化が小さいポリアン化ビニリデン系動脂組成物を提供することにある。

8

【0021】また、本発明の目的は、高い光線透過率と低い鏤価を有する透明性に優れたポリファ化にエリテン系樹脂組成物を提供することにある。さらに、本発明の目的は、このような半導電性及びごまたは透明性に優わた樹脂組成物を用いて、チューブ、シート、ファイニー、射出成形物などの半導電性及びごまたは透明性の各種成形物を提供することにある。

[0023]

【課題を解決するための手段】本発明によれば、ポリフィ化ビニリテン系樹脂(A)100重量部に対して、式(1)

[0024]

【化3】

$$\begin{bmatrix} R^1 \\ I \\ R^2 - N - R^4 \end{bmatrix} R^5 SO_4$$
 (1)

【0.02.5】 (式中、 $R^1 \sim R^1$ は、互いに同一または 相異なるアルキル基であり、 R^2 は、アルキル基、フル オロアルキル基、または水素原子である)で表されるア ルキル四級アンモニウム硫酸塩(B.1)、及び式(2)

[0026]

【化 1】

$$\begin{bmatrix} R^{8} \\ I \\ R^{7} - N - R^{9} \\ I \\ R^{8} \end{bmatrix} R^{:0}SO_{3}$$
 (2)

【0027】 (試中、 $R^6 \sim R^8$ は、互いに同一または相異なるアルキル基であり、 R^8 は、アルキル基 フルカロアルキル基、または水素原子である)で表されるア ルキル四級アニモニウム亜硫酸塩(B2)からなる群よ

.)

り選ばれる少な。とも一種の化合物(B)を0.03~10重量部の割合で含有するポリアッ化ビニリデン系樹脂組成物が提供される。また、本発明によれば、数ポリスラ化ビニリデン系樹脂組成物が応なる成形物が提供される。

[0028]

【課題を解析するための手段】ホリング化ビニリデン系 樹脂

本発明で使用するボリノッ化ビニリデン系術脂(A)としては、フッ化ビニリデンのホモボリマー(すなわれ、ボリフッ化ビニリデン、PVDF)、及びフッ化ビニリデンを主構成単位とするファ化ビニリデンと他の共重合可能なモノマーとの共重合体を挙げることができる。ファ化ビニリデン共進合体、ファ化ビニリデン・キサフルオロエチレン共重合体、ファ化ビニリデン・デトラフルオロエチレン共重合体、ファ化ビニリデン・サトラフルオロエチレン・スキサフルオロアロとした。また、これらボリフッ化ビニリデン系樹脂は、それぞれ単独で、あるいは2種類以上を組み合わせて使用することができる。【4029】ボリファ化ビニリデン系樹脂は、それぞれ単独で、あるいは2種類以上を組み合わせて使用することができる。

【0029】ボリアッ化ヒニリデン系樹脂の中でも、耐 汚染性、耐ナブン性、耐容剤性の観点からは、アールビ ニリデンのホモボリザーであるPVDFが好ましい。薬 軟性や引き裂き強度の観点からは、アッ化ヒニリデンを 計構成単位とするアッ化ヒニリデン共和合体を単独で、 あるいはPVDFとアレンドして使用することが好まし い。接着性を向上させるには、官能基を導入したアッ化 しニリテン共兼合体が好適に使用される。ボリアッ化ビ ニリデン系樹脂は、アクリル樹脂や他のアッ素樹脂など のその他の熱可塑性樹脂を、本発射の目的を妨けない範 30 囲内でアレンドして用いてもよい。

【0030】アルキル四級アンモニウムの硫酸塩及び亜 硫酸塩

本範囲で使用するアルキル関級アンモニウム硫酸塩 (B-1) は、式(1)

[0031]

【生5】

$$\begin{bmatrix} R^1 \\ I \\ R^2 - N - R^4 \\ I \\ R^3 \end{bmatrix} R^5 SO_4 \tag{1}$$

【0.0.3.2】(丸中、 $R^1 \sim R^3$ は、互いに同一または相異なるアルキル基であり、 R^6 は、アルキル基、フルゴロアルキル基、または水素原子である)で表される化合物である。本発明で使用するアルキル四級アンモニウム亜硫酸塩(B.2)は、式(2)

[0033]

【化6】

$$\begin{bmatrix} R^{8} \\ I \\ R^{7} - N - R^{9} \\ R^{8} \end{bmatrix} R^{10} SO_{3}$$
 (2)

10

【0031】(式中、R'~R'は、互いに同一または相異なるアルキル基であり、R'は、アルキル基、アルオロアルキル基、または水素原子である)で表される化合物である。これらの化合物の中でも、安定性に優れることがら、アルキル匹級アンモニウム硫酸塩(B1)が10 好ましい。

【0035】これらか化合物(B)において、R²~R² またはR⁴~R² におけるアルキル基の農薬数の合計は、通常 1月上であるが、好ましては8~30。より好ましては12~21、特に好ましては15~20である。アルキル基としては、メチル基、エチル基、プロビル基、イブプロビル基、アチル基、エチル基、プロビル基、イブプロビル基、アチル基、スンチル基、フロビル基、イブプロビル基、アチル基、スンチル基、フロビル基、アル基などの短鎖アルキル基を例示することができる。R 及びR²がアルキル基である場合には、メチル基やエチル基などの短鎖アルキル基が代表的なものである。R 20 及びR²がフルオロアルキル基である場合には、CF、などの短鎖アルオロアルキル基が代表的なものである。

【0036】これらの化合物(B)の具体例として、例えば、(CH):N*、(C;H):N*、(C;H):N*、(C;H):N*、(C;H):N*、(C;H):N*、(C;H):N*、(C;H):N*、(C;H):N*、(C;H):N*、(C;H):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N*、(CH;N):N* (CH;N):N* (CH;N):N

(C(H) (NHSO)。 か特に好ましい。これらの信令物は、それぞれ単独で、あるいは2種以上を組み合わせて使用することができる。

【0037】ポリノー化ビニリテン系樹脂は、通常、他の物質と単に結離混合しただけではる型構造を呈するか、アルキル四級アンモニウムの硫酸塩または亜硫酸塩 締加すると、溶融混合の過程で、ポリアン化ビニリデン系樹脂から型構造になる。このことから、これらの化合物は、ポリアン化ビニリテン系樹脂に対して、み型結晶 枠剤として作用していると考えられる。

【0038】ボリソー化ビニリテン系樹脂組成物 4発明のボリソー化ビニリザン系樹脂組成物は、ボリソ で化ビニリテン系樹脂(A)と前記化合物(B)とを含 有する樹脂組成物である。化合物(B)の配合制合は、 ボリソフ化ビニリテン系樹脂(A) 100重量部に対し て、0、03~10重量部の範囲内であって、好ました

50

は0.05~8重量部、より好ましては0 1~5重量 部、特に好すし、はロ、3~2重量部である。この配合 割合が過小であると、化合物(B) / 4 添加による改善的 果が小さり、渦七であると、樹脂の着色や加工時の分解 発泡を生しることがある。なお、化合物(B)の好まし い配言割合は、要求される物性によって一適宜定めるこ とかてきる。

【0039】特開平8~99374号公報や特開平7~ 28266号公報に示されているように、電子写真式復 写機やレーサービーム式プリンターなどにおいて使用さ 10 れる転写へルトは、強性率の高いものが好ましい。 具体 的には、ヘルトのヤング科が1、0GPa以上であるこ とが好ました。1、5GPa以上であることが特に好ま しい。ところが、前記化合物(B)の孫加量が多しなら と、樹脂組成物が心形域された。一下のヤンで多が極端 に低下する傾向を示す。したかって、このような樹脂組 成物を電子写真方式の画像形成装置の帯電ールトに使用 すると、経時により帯電ニルトが伸びてしまい、転写工 程で画像スレが発生するという問題がある。本発明のポ リフッ化ピニリデン系樹脂組成物を、電子写真式復写機 20 やレーザーヒーム式プリンターなどにおいて転送しいし として使用する場合には、ポリフッ化ビニリデン系樹脂 (A) 100重量部に対する前記化合物(B)の配合割 合は、ロニロ3~5重量部か好ました。ロー1~3重量 部がより好ました。0.3~2重量部が更に好ました。 0.5~1 重量部が特に好ましい。

【0010】な発明のポリファ化ビニリデン系樹脂組成 物を透明性が要求される分野で使用する場合。より具体 的に、例えば、事務用品、OA機器、建築材料、看板の 表面保護材料として使用する場合には、前記式(1)で 30 定義される吸光度比Rでは、0. 8以下が好まして 5以上がより好まして、り、3以下がさらに好まし 、 0、 1 は上か特に好ました。 方、 4発明の樹脂組 成物を元学しょスや先ファイバー、元学フィルタなどに 使用する場合には、Raは、0. 5以上が好まして、 O. 3以下がより好まして、O. 1以下がさらに好まし 「、0.05以上が特に好ましい。Raは、所望によ り、り、02以下にすることが可能である。

【0011】唆光度は、ポリファ化ヒニリテン斉樹脂。 (A) の単量体組成、化合物(B)の種類。化合物 (B) の添加量、延伸加工の有無などによって変化す る。したがって、改先度氏の調節は、ナリコー化ビニリ デン系樹脂(A)や化合物(B)の種類の選択、化合物 (15) わ終加量の調整、延伸加毛条件の調整。 てんらの 組み合わせにより、好適に行うことができる。例えば、 図3に示されるように、化合物(B) の番加量を増加さ 世れば、噂光度比が低下する。また、後記の実施例11 ~12に示されるように、例えば、ボリコン化ビニリデ ン系樹脂組成物の、一下左延伸すれば、吸光度比を著し 三小さ「することがてきる。化合物 (B) の標加量の調「50」押出機とスパイサル環状タイプを用いて、ダイスのサッ

整と延伸処理を組み合わせてもよい。吸光度比の下限 は、Dαがゼロの場合、Oとなる。

【0042】他の孫卯物

本発明のデリフト化ビニリデン系樹脂組成物を透明性分 野使用する場合には、他の添加剤をできる限り含有させ ないことが望ましいが、薄電性分野で使用する場合に は、所望により他の添加物を含有させることができる。 他の孫加物としては、例えば、タルフ、マイカ、シリ カ、アルミナ、カオリン、フィライト、チダ、酸カリウ ム、酸化チタン、酸化亜鉛、酸化鉄、水酸化マクネンウ ム、貨酸カル、ウム、炭酸ニッケル、硫酸カル、ウム 硫酸パリウム、水酸化デルミニウム、ガラス粉、石英粉 村、黒鉛、無機顔料、有機金属塩、他の酸化金属などの。 粒状または粉末近ツィラー;原素繊維、ガラス繊維、ア スパスト繊維、シリカ繊維、アルミナ繊維、シルコボゲ 繊維、睾化ホウ素繊維、睾化ケイ素繊維、ホウ素繊維、 チタン酸カリ繊維などの繊維状フィラー、などが挙げる わる。これらのフィコーは、本発明の目的を阻害しない。 範囲内で、使用目的に応じて適宜配合することができ Ξ,

【0013】また、サリファ化ビニリテン系樹脂組成物 には、例えば、酸化防止剤、滑剤、可塑剤、有機節料、 無機預料、紫外線吸収剤、界面活性剤、無機酸、有機 酸、p日調整剤、架橋剤、カップリンで剤などの汎用の 孫加剤を、本発明の効果を阻害しない範囲内で、適宜配 合することができる。

【0011】樹脂組成物の調製法、成形法、及び用途 4.発明のポリコッ化ビニリテン 至樹脂組成物の調製法に は、特に制限がなり、好適な方依としては、例えば、① ポリファ化ビニリテン系樹脂の燃料または、レットと、 前記化合物 (B) とをミキサーなどの混合機で混合する 方法、②音成分を混合機工混合した後、混合物を宿禰押 出し法によって コーノト化する方法、3倍成分を水また は水と水溶性溶剤との混合溶剤に溶解ないしは分散さ せ、ミキサーなどの混合機で混合した後、乾燥し、得ら れた乾燥物を容融押出して、レット化する方法などか挙

【0015】 本種明のポリング 化ビニリラン 新樹脂組成 物は、フレス成形法、溶融押出法、射出成形法、痞液流 40 延払、産布法などの各種成形法により、各種成形品や被 **覆成形品に成形加工することができる。また。ガリツッ** 化ビニリテ、系樹脂 (A) に化合物 (B) を高濃度で含 有させたマスケーノ、バモを作成しておき、成川時に必要 に応した化合物(B)の濃度になるように、診樹脂で希 釈してから成別加工することもできる。

【0016】本発明のポリコン化ビニリテンぎ 樹脂組成 物をシームレス・ルーに押出成刑する場合は、連網路融 押出成刑法が好まして用いられる。シームレス・ルトの 望ましい連続容融押出成形法としては、1軸スツリュー

プから直下に押出し、内部冷却マノトレル方式によって

内径を制御しなから引き取る方法等があげられる。 料発

つけつつ、プローブの内側電極と測定ステーミとの間に 500 Vの電圧を印加して、抵抗率測定装置(商品名: ハイレスターP」三菱化学社製)で体積抵抗率 o。を求 めた。このようなリンツ電極法による体積抵抗率側定法 の詳細は、JIS-K6911を参照することができ Z, ,

14

明のポリファ化ビニリデン系樹脂組成物を用いてシート 有製造する場合、連続押出成形法として、1軸または2 軸スクリュー押出機とエダイスとを用い、容融状態の該 樹脂組成物をリップから直上に押出し、冷却上ラム上に エアーナイフなどにより密着させつら冷却固化する方法 を挙げることができる。 な発明のポリ たっ化ビニリデン 系樹脂組成物を溶融状態が引調化させるには、冷却温度

【0019】(3) 平均値の算出

た。30~100℃の範囲内に制御することが好まし 、ロシ30℃の範囲内に制御することが特に好まし

上記した厚みと体積抵抗率の測定は、これらの値を測定 すべき試料の表面積1m 当たり任意に選んた20点の 測定点、もしては任意に選んだ20個の成形物について 1個に付き1点(計20点)測定し、その最大値、最小 値、平均値 (算術平均) を求めた。

J 1 8 - K 7 1 1 3 に準拠し、幅 1 0 m m、長さ 1 0 0

mmの短冊型試験片を用い、引張試験機(TENSIL

ON RTM100型、オリエンテラク社製)により引

張連度50mm~分、チャップ間距離50mmの条件で

【0017】 な発明のポリ 1 化ビニリデン系 樹脂組成 物は、電子部品包装用の静電気防止フィルム、静電気防 止容器、各種OA機器に使用される体吸着防止部材、除 電部材、真電部材、レンズ、光学フィルター、透明フィ ルム、透明容器などに好適に用いられる。 本発明のまり プラ化ビニリデン系樹脂組成物の成形方法は、特に制限 されるものではなり、射出成形や溶融押出法などの公知 の成形方法により、例えば、デートリやファイバー状に 成形加工することが可能である。加工後、さらに、延伸 や勢固定せることも可能である。 本発明のポリフラ化ビ ニリティ系樹脂組成物は、それ単独で使用してもよう また、必要に応して他の樹脂層などと複合化させて、積 層1、十十位複合系にして使用してもよい。

(1) ヤンツギ

測定した。

【ロロ50】(5)体積抵抗率の湿度依存性

[0048]

本発明において、リング状電極を有するいかしティビデ イセル(商品名:HP1ら008B、ビューレットパッ カート社製、内側の電極の直径とも、Omm、外側の電 極の内径38、0mm、外側電極の外径10、0mm) に荷重でよるでサンプルを挟み、所定の温度と程度に調 節された恒温恒湿槽(商品名 LH30 13M ナガ 7科学機械製作所社製)中で21時間放置した後、内側 電極と対向電極との間に100Vの電圧を1分間(厚み 方向に) 印加したときの体積抵抗率力、を抵抗測定器 (簡品名) ハイレンスタンスメータHP1339A、ビ 30

【実施例】ロトに、実施例及び比較例を挙げて、な発明 についてより具体的に説明する。物性の測定法は、次の とおりてある。

- ユーレットパーが一下社製して求めた。このようなリン 7電極法による体積抵抗率側定法の詳細は、118 K 6911を参照することがてきる。体積抵抗率は、相対 湿度30%、50%、70%、及び90%の順に脊湿度 環境で24時間調湿した後、測定した。

【0051】 (6) 表面抵抗率の湿度依存性

成形物の厚みは、ダイヤルゲーに厚み計(小野御器社 製、商品名 DG 911) で測定した。

> 本発明において、リング状電極を有するレジンティビデ マセル (商品名 HP16008B、ヒューレット/・・ カート社製、内側の電極の直径26.0mm、外側の電 極の内径38 りmm、外側電極の外径10.りmm) 節された恒温恒湿槽(商品名。LH30-13M、ナガ プ科学機械製作所針製)中で2.1時間放置した後、内側 電極と外側電極との間に10Vの電圧を1分間(表面方 向に) 印加したときの表面抵抗率が。を抵抗測定器(商 品名 フィイエ・スクンフィーグHP4339A、モュー レコリバッカー子社製)で求めた。このようなサング電 極法による表面抵抗率測定法の詳細は、JIS K69 1.1 を参照することができる。表面抵抗をは、自対温度 30%、50%、70%、及む90%の順に各温度環境 - で24時間調湿した後、測定した。

(2) 体積抵抗率

(1) 厚灰粗泥

本発明において、体積抵抗率か10°Qcm以上の試料 は、リング状電極を有するレントディビディセル(商品 名。HP16008お、ヒューレットバッカート社製、 内側の電極の直径2.6、0mm、外側の電極の内径3。 8. りmm、外側電極の外径10. りmm)に荷重7k とでせい だいた挟み、内側電極と対向電極との間に1k Vの電圧を1分間(摩み方向に)印加したときの体積抵 40 に荷重7kgでサニブルを挟み、所定の温度と環度に調 抗する。を抵抗測定器(商品名)ハイレジスタンスメー クHP 1339A、ビューレットハッカート社働) でま めた。このようなリング電極法による体積抵抗率制定法 の詳細は、TIS Kら911を参照することができ る。を毎明において、体積抵抗率が10°Ωcm主流の 試わば、リンク状プロープ(商品名:HRSプローフ、

菱化学社製、内側の電極の直径5.9mm 外側の電 極少均径11、0mm、外側電極の外径17、8mm) と朝足(汗ージ(簡品名)レンデーブルFL」。 菱化学 礼動)との間に試料を挟み、約3kg重の圧力で押さえ。50。

【0052】(7)曇価(HAZE)

養価は、「イブメータ(商品名:Σ80、日本電色工業 社製)を用いて側定した。養価の側定方法の詳細は、J IS - K7015を登開することができる。

(8) 赤外線吸収スペットル (IR)

赤外線吸収ス (プトルは、プーリエ変換赤外分元光度計 (商品名 FTIR 8200、島建製作所社製)、全 反射側定セル (商品名 ATR 8000、島津製作所 社製)、及むプリズム (KRS 5、島津製作所社製)*

$$R_{\alpha} = D_{\alpha} / (D_{\alpha} + D_{\beta})$$

【0054】ただし、xcm における赤外線吸収スペ ニトルの吸光度Dxは、xcm における入射光の強度 10と透過光の強度1から式(11)式より末められ ※

$$D_x = log_{10} (l_0/I)$$

【0056】なお、吸光度を求めるペースラインは、図8のB及びCに立てように、500cm 付近と545cm 付近にある出に接線を引くか、Dβが極めて大きい場合には、そのように接線を引くた、520cm 付近の出に接線が交わるので、図8のAに示すように、545cm 付近の出と520cm 付近の出に接する接線なっ、並びに、520cm 付近の出と500cm 付近の出に接する接線なっ、並びに、520cm 付近の出に接する接線なった引くことにより定め、そして、この一つラインに基づいて、Da及びDaを求める。

(10) 示范走青熱量測定 (DSC)

示差走だ熱量測定装置(製品名 * DSC 3 0、Me t t l e r 往襲)とデータプロセッサ(製品名 * TC 1 0 A、 Me t t l e r 往製)とを用い、下記条件により 30 DSC 法によって測定した。

条件「試料重量10mg、測定開始温度30℃、測定終 「温度250℃、基温速度10℃」ケ

【0057】 (医療例1~7、及び比較例2~6 麦1 に示す組成の樹脂粉末及び添加剤を混合機 (川田製作所料製、商品名 ツーハーミキサー) に投入して、回転数 1000 r p m 可約5 分間充分に機種混合した。次い で、得られた混合物を1軸スツリュー押出機 ビデ技研 社製) を用いて、タイツ温度2 10 ℃で直径約3 m m 程度にポレットをした。このペレットを2 3 0 ℃ で アレス 40 成進直後、20℃で急治して、厚さり、25 m m のシートを得た。物性の測定結果を表1に示す。

【0058】 実施例8 表1に示す組成の樹脂粉末及 で特加剤を用い、プレフ成州直接に100℃で行給した 担外は、実施例1~7と同様にして、厚さの、25mm の、~-! を得た。物性の測定結果をま1に示す。

【0059】 実施例9及210 妻1に示す組成の樹脂物和及2益加剤を混合機 (川田製作所社製、商品名 2一パー・キサー) に技人して、回転数1000rpm で約5分間充分に攪拌混合した。さいて、得られた混合 50

* を用いて、ATR法(Attenuated Tota 1 Reflectance)により、100cm か ら1000cm の範囲で測定した。

16

(9) 吸光度比Ra

531cm における赤外縛吸収フークトルの吸光度Daと、511cm における赤外繰吸収フークトルの吸光度Daとから式(I)式より未めた。

[0053]

【数2】

(I)

× 1.

[0055]

【数3】

 (Π)

物を1軸スクリュー押出機(プラ技研社製)を用いて、 ダイス温度240 Cで直径約5 mm程度に ペレット化し た。このようにペレット化した原料を1軸スクリュー押 20 出機(プラ技研社製)を用いて、リップクリアランツ 0.7 mmの工型ダイス(ダイノ温度240 C)に供給 し、ダイスから押出された溶融材脂を90 Cの冷却ロー ルによって、一下に成形した。物性の測定結果を表1に ※す

【0060】 [奨施例11] 奨施例10 (得られた) 一 上を110 (に関節したテンターフリップ式延伸機により、縦方向に3.5倍に延伸し、厚さ35μmの一軸配 向フィルムを得た。このフィルムの改元度比R点は、 0.05であった、物性の測定結果を表1に示す。

【0.061】 [実施例 1.2] 実施例 1.0 工得られたシートを 1.40 でに調節したテンターフリップ式延伸機により、縦が向に 3. 5 倍に延伸し、さらに横が向に 3. 5 倍に延伸して、厚さ 1.0 1.0 工 軸配向フィルムを得た。 このフィルムの吸光度比R 1.0 1.0 このフィルムの吸光度比R 1.0 1.0 こので、物性の測定結果を表 1.0 に示す。

【0062】 (比較例1) PVDF ペレットを230°C でプレス成形した後、20°Cで急給して、厚さり、25 mmのシートを得た。物性の測定結果を装1に示す。

【0.063】 「比較例 7 PVDF 、いっトを 1 軸 2 リカー押出機(プラ技研社製)を用いて、リッククリアランス 0 、 7 mmの 下型タイス(タイス温度 2.40%)に供給し、ダイスから押出された溶融材脂を 9.0%の冷却いったによって、一上に成刑した。物性の測定結果を表1に示す。

【0.06.4】 「比較例8」比較例7で得られたレートを1.40℃に調節したテンター 9.7では延伸機により、 縦方向に3.5倍に延伸して、厚5.3.5 μ mの一軸側向 フィルムを得た。このフィルムの吸え度比比 α は、0.9.7であった。物性の測定結果を表1に示す。

【0065】 [比較例9] 比較例7で得られたシートを

140℃に調節したテンタークリップ式延伸機により、 縦方向に3.5倍に延伸し、さらに、横方向に3.5倍 に延伸して、厚さ10μmの三軸配向フィルムを得た。 このフィルムの吸光度比Raは、0.59であった。物*

*性の測定結果を表1に示す。

[0066]

【表 1 】

		組成	(暗量重)	体積抵抗率 (Ωcm)		cm)	HAZE
		樹脂	添加剂	平均值	最大值	長小値	(%)
	1	PVDF(100)	TBAHS(0.1)	1.3 × 10 ¹¹	$1.8\times10^{\rm tt}$	9.7 × 10 ¹⁰	39.9
	2	PVDF(100)	TBAHS(0.3)	3.6 × 10 ¹⁰	4.9 × 10 ¹⁰	2.9 × 10 ¹⁰	38.1
لىل	3	PVDF(100)	TBAHS(0.5)	2.9 × 10 ¹⁰	3.2 × 10 ¹⁰	1.4 > 1010	35.8
実	4	PVDF(100)	TBAHS(1.0)	6.3 × 10°	8.8 ^ 10 ^s	4.0 × 10°	49
+4:	5	PVDF(100)	TBAHS(3.0)	1.8 × 10°	2.4 × 10°	1.2×10^{9}	2.8
施	6	PVDF(100)	TBARS(5.0)	1.2 > 10°	2.0 × 10°	9.1 × 10°	4.5
April 1	7	VDFP(100)	TBAHS(1.0)	1.0 × 10°	1.6 > 10°	8.7 > 108	2.0
6 91	8	PVDF(100)	TBAHS(1.0)	1.0 × 10 ¹¹	2.2 > 10 ^{ct}	7.9 × 10 ¹⁰	10.4
	9	PVDF(100)	TBAHS(0.3)	2.8 × 10 ⁿ	3.5 × 10 ¹¹	1.8 × 10 ¹¹	8.5
	10	PVDF(100)	TBAHS(1.0)	5.3 × 10 ¹⁰	7.0 × 10 ¹⁰	4.3 · 10 ¹⁰	1.3
	11	PVDF(100)	TBAHS(1.0)	1.2 × 10 ¹²	2.7 > 1012	8.3 × 10 ¹¹	1.0
	12	PVDF(100)	TBAHS(1.0)	2.0×10^{12}	4.1 > 10 ¹²	1.1×10^{12}	0.2
	1	PVDF(100)	-	3.0×10^{14}	4.8 \ 1014	2.1×10^{14}	46.4
	2	PVDF(100)	TBAHS(15)	8.0 < 10 ⁸	3.5 > 10°	2.6 • 108	25.5
比	3	PVDF(100)	TEABr(1.0)	5.4 × 10 ¹²	1.1 > 10 ¹⁸	2.4 × 1012	53.7
	4	PVDF(100)	TBABr (1.0)	2.7 × 10 ¹¹	5.6 × 10°	1.3 × 10 ¹¹	43.1
較	5	PVDF(100)	TEAC1(1.0)	6.8 × 10 ¹²	1.3 × 10 ¹⁸	4.3 × 10 ¹²	59.5
	6	PVDF(100)	MAC1(1.0)	2.2×10^{12}	4.5 × 10 ¹²	1.0 · 1012	58.0
例	7	PVDF(100)		2.4 × 1014	4.2 × 10 4	1.8 × 1014	42.6
	8	PVDF(100)	-	5.2 > 10 ¹⁴	77 > 10.4	2.3 × 10 ¹⁴	4.6
	9	PVDF(100)	_	$8.1 > 10^{14}$	2.8 × 10 ¹⁵	3.7×10^{14}	3.2

【0067】脚注:

- (1) PVDF:ポリフッ化ビニリデン〔呉羽化学工業
- (株) 製、KF#1000]
- (2) VDFP:フッ化ビニリデン 六フッ化プロピレ ン共重合体〔呉羽化学工業(株)製、KF#2300〕
- (3) TBAHS (C₄H₀) ₁NHSO₄ (富山薬品で 業(株)製〕
- (4) FEABr (C₂H₁)₄NBr 〔和光純要
- (件) 製)
- (5) TBABr [CH₂(CH₂)₃]₄NBr 和光 純巢(株)製〕
- (6) TEAC1 (C₂H₂) ₄NC1 (和光純薬
- (株) 製)
- (7) MAC1: CH₁NH₁C1 〔和光純薬(株) 製〕
- 【0068】表1の結果から明らかなように、本発明の ポリファ化ビニリデン系樹脂組成物(実施例1~10) は、体積抵抗率が適度に低く、バラソキも少なり、しか も曇価が小さいものである。また、本発明のポリフッ化 50 明らかなように、TBAHSの添加量が大き上なるに従

ビニリデニ系樹脂組成物は、配合割合や成形条件を選択 することにより、曇価を著し、小さ、することができる。 (実施例4~10)。さらに、実施例1~10におい て、試料中に凝集物やフィッシュアイは観察されず、春 加剤のブリードウトも観察されなかった。

【0069】これに対して、添加剤がない場合(比較例 1及び7)、化合物(B)の配合割合が大きすきる場合 40 (比較例2)、本発明の化合物(B)以外の添加剤を指 加した場合(比較例3~6)には、いずれも不満足な結 果しか得ることができない。特に比較例2~らでは一〇 レット化の際に樹脂組成物が褐色に着色し、分解発泡し た。したかって、割1に示されている比較例2~6の物 性は、着色発泡・一下についての測定値である。また、 比較例3~6のプレフシートは、アンモニア県がした。 【0070】ヤング 奉の測定

実施例1~6、及び比較例1 1調製した名サンプルを用 いてヤンデ室を測定した。結果を図1に示す。図1から

って、シートのヤンダギが急塵に低下する傾向を示す。 HAZEの測定

実施例1~6. 及び比較例1で調製した各サンプルを用いてHAZFを測定した。結果を図2に示す。図2から明らかなように、TBAHSの採加量が大き。なると、ニートのHAZEが急激に小さっなり透明性が増す傾向を示す。

Raの測定

実施例 $1 \sim 5$ 、及び比較例 1 で調製した各サンプルを用いてR α を測定した。結果を図るに示す。図 3 から明ら 10 かなように、TB Δ H S の 孫加量が大き 1 なると、1 一下のR α は色像に小さくなる傾向を示す。

【0071】DSC测定1

実施例2、実施例4、実施例5、及び比較例1で調製した各サンプルを用いてDSC側定を行った。結果を図4に示す。図1から明らかなように、実施例2、実施例4、及び実施例5かDSCチャートには、185~200での範囲に、比較例1には見られないピーツが観察される。

DSC測定と

実施例4及び 実施例8で調製した各サンプルを用いてDSCを測定した。結果を図5に示す。図5から明らかなように、プレス成形後に徐倫した実施例8のDSCチャートでは、実施例4で見られる185~200℃の範囲のビーケが消失する。

【0072】体積抵抗率の測定

実施例10 「調製したサンブルを用いて、体積抵抗率の 湿度依存性を測定した。結果を図らに示け。図らから明 らかなように、本発明のエリファ化ヒニリデン系樹脂組 成物から得られたシートは、体積抵抗至の湿度依存性が 30 小さい。

表面抵抗率の側定

実施例10 て調製したサンプルを用いて、表面抵抗率の 湿度依存性を測定した。結果を1977に示す。1973から明 らかなように、本発明のボリファ化ビニリデン系材脂組 成物から得られたシートは、表面抵抗率の湿度依存性が 小さい。

[0073]

【発明の効果】本発明によれば、10°~10°Ω c m の範囲内で所望の体積抵抗率を安定して均一に精度より 発揮することができ、環境程度変化による体積抵抗率と 表面抵抗率の変化が小さいポリコー化ピニリテン系樹脂 組成物が提供される。このポリコー化ピニリテン系樹脂 組成物を用いて、チューフ、シート、ファイバー、射出 成形物などの半導電性成析物を得ることができる。ま一* *た、本発明によれば、曇価が低さ、透明性に優れるポリファ化ビニリデン系樹脂組成物が提供される。このポリファ化ビニリテン系樹脂組成物を用いて、チェーブ、ミート、ファイバー 射出成形物などの透明性成形物を得ることができる。

【ロロテオ】本発明のポリノッ化ヒニリデン系樹脂組成 物は、平導電性分野としては、電子写真方式の画像用成 装置における帯電ロール、転写ロール、現像ロール、帯 電ニルト、陰電ニルトなどの荷電制御部林の正なことも 表面層を形成する材料として好適である。ロール状部材 としては、芯金上に直接または他の樹脂層及び。または ゴム層を介して、最外層にポリコッ化,ピニリテン系樹脂 組成物層が形成されたものが挙げられる。また、本発明 の樹脂組成物は、電子部品包装材(例えば、フィルム) 袋、岩器)、壁紙、OA機器外装材、帯電防止の間仕切 り、粉体室装付の搬送チューブなどの各種荷電制御部村 として好適である。 本発明のポリファ化ビニリテン 系樹 脂組成物は、透明性分野として、光ファイバー、光ファ イント-の鞘成分、元学レンプ、窓カラス、窓カラス保護 20 村、ディスプレイ保護材、CR1保護村、大陽電池の透 元材、照明のカバーなどの光学部材として好適である。

【図面の簡単な説明】

【図1】図1は、実施例1~6、及び比較例1 て調製した高サンプルのヤング率を、タイカンチルアンモニウムンイトログンサルフェート(TBAHS)の番加量との関係で示した図である。

【図2】図2は、実施例1~6及び比較例1 7調製した 各サンプルの優価を「BAHSの標加量との関係で示し た図である。

【図3】図3は、実施例1~5及び比較例1 1間製した 各世ンプルのRaをTBAHSの希加量の関係で示した 図である。

【図4】図44は、実施例2、実施例4、実施例5、及む 比較例1 て調製した各サンバルを用いて、DSC測定を 行った結果を示す図である。

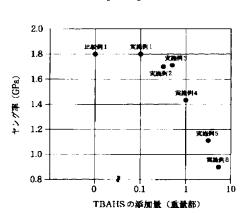
【図5】図5は、実施例1及び実施例8で調製した寄サコプルを用いて、DSC測定を行った結果を示す図である。

【図6】図6は、実施例10 T調製したサニアルを用い 40 て、体積抵抗率を湿度との関係ではした図である。

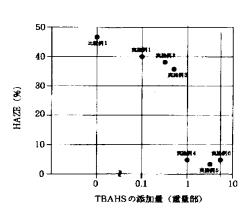
【図7】図7は、実施例10 1 調製したサミアルを用いて、表面抵抗率を湿度との関係で示した図である。

【図8】図8は、赤外線吸収スペプニルの噴光度を求めるペープラインの確定法を示す回てある。

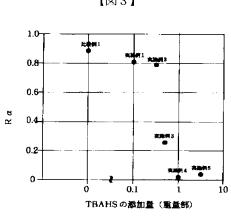
【図1】



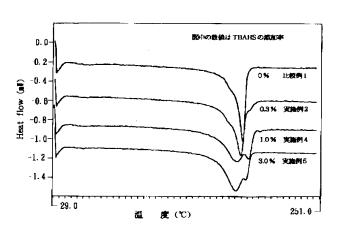
【図2】



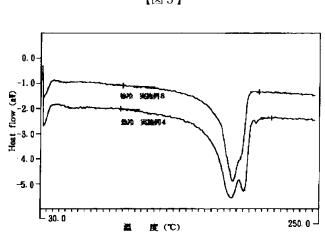
【図3】



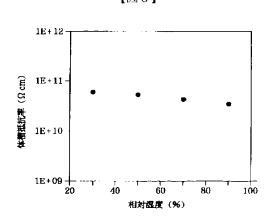
【図4】



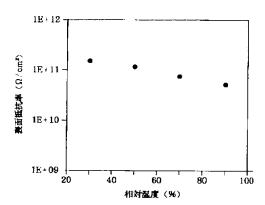
【図5】



【図6】



【図7】



[図8]

